【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成17年4月21日(2005.4.21)

【公開番号】特開2002-270650(P2002-270650A)
【公開日】平成14年9月20日(2002.9.20)
【出願番号】特願2001-382626(P2001-382626)
【国際特許分類第７版】
　Ｈ０１Ｌ　21/60
【ＦＩ】
　Ｈ０１Ｌ　21/60　　３１１Ｗ

【手続補正書】
【提出日】平成16年6月11日(2004.6.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
有機絶縁性フィルム、接着剤層、保護フィルム層からなる積層フィルムであって、有機絶縁性フィルムの厚さが３～８０μｍ、接着剤層の厚さが２～２０μｍ、接着剤層付きの有機絶縁性フィルムの水分含有率が０．３～３ｗｔ％であり、接着剤層はフェノール樹脂、フェノールアラルキル樹脂、フラン樹脂、アミノ樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、ジアリルフタレート樹脂、エポキシ樹脂、ビニルエステル樹脂、フェノキシ樹脂、ポリウレタンから選ばれる少なくとも１種類以上の樹脂を含むことを特徴とする積層フィルム
【請求項２】
前記積層フィルムにおいて接着剤層付きの有機絶縁性フィルムを７５℃以上に加熱して金属箔を貼り合わせることを特徴とする請求項１記載の積層フィルム。
【請求項３】
有機絶縁性フィルムの厚さが３～６０μｍであることを特徴とする請求項１記載の積層フィルム。
【請求項４】
金属箔が銅箔であることを特徴とする請求項２記載の積層フィルム。
【請求項５】
請求項１記載の積層フィルムを用いたことを特徴とする電子部品材料。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
【課題を解決するための手段】
　すなわち、本発明は有機絶縁性フィルム、接着剤層、保護フィルム層からなる積層フィルムであって、有機絶縁性フィルムの厚さが３～８０μｍ、接着剤層の厚さが２～２０μｍ、接着剤層付きの有機絶縁性フィルムの水分含有率が０．３～３ｗｔ％であり、接着剤層はフェノール樹脂、フェノールアラルキル樹脂、フラン樹脂、アミノ樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、ジアリルフタレート樹脂、エポキシ樹脂、ビニルエステル樹脂、フェノキシ樹脂、ポリウレタンから選ばれる少なくとも１種類以上の樹脂を含むことを特徴とする

積層フィルムである。